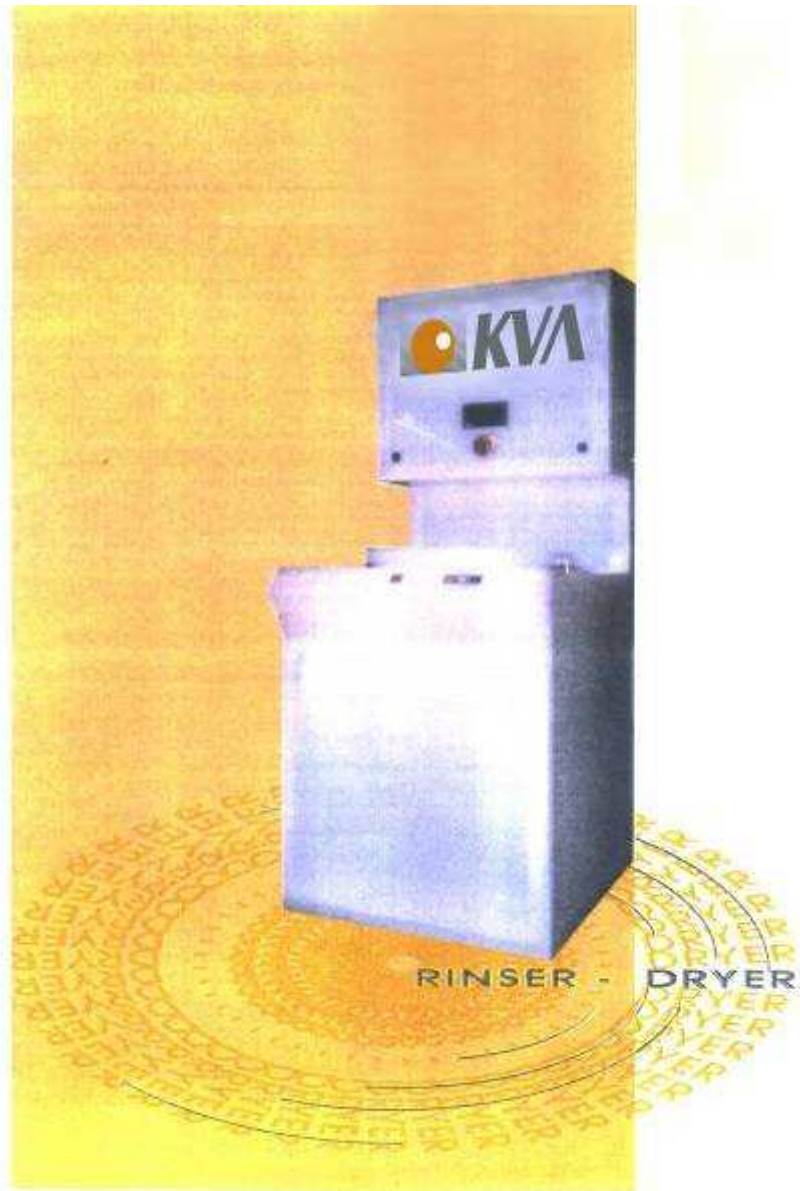


2010



[KVA RINSER-DRYER]

KVA Scheibentrockner - Kompaktgerät zum Spülen und Trocknen von Silizium- Scheiben
KVA Rinser/Dryer – Compact station for rinsing and drying of silicon wafers

KVA Scheibentrockner Kompaktgerät zum Spülen und Trocknen von Silizium-Scheiben

Funktionsmerkmale:

Sämtliche medienberührte Teile aus PVDF-UHP/PFA sowie sämtl. Metallteile in PVDF eingeschweißt und dichtgeprüft.

Dadurch Metallionenkontamination ausgeschlossen.

Spülung der Prozesskammer mittels N₂ bzw. Reinluft (point of use filtration 0,2µ). Prozesskammer wird auf Überdruck gehalten

Spülung mittels VE (DI) H₂O sowie absolut fleckenfreier Trocknung im Fliehkraftprinzip. (G-Force)

Reinigung der Scheiben mittels VE (DI) H₂O (Point of use Filtration 0,2µ). Anpassung der Scheibenverunreinigung durch Veränderung der Spülintensität bzw. Spüldauer möglich.

Getrennte Absaugung der Rotorachse im Durchspülprinzip sowie der Antriebs-elemente

Vollautomatischer Programmablauf über SPS.

Überwachung sämtlicher Sicherheits-sowie Programmfunktionen. Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeleittechnik

Spül/Trocknenzyklus läuft vollauto-matisch nach Programm ab.

Spülen bei niedriger Drehzahl

Vortrocknung bei hoher Drehzahl (1250 UPM)

Nachtrocknung bei niedriger Drehzahl (750 UPM), optimale Schonung der Scheiben.

KVA Rinser/Dryer for rinsing and drying of silicon wafers

Features:

All parts machined of PVDF-HP/PFA media as well as all metal parts hermetically sealed in PVDF-HP, thus excluding contamination through metal ions.

Flushing of the process with N₂ or pure (point of use filtration 0,2µ)
The process chamber remains pressurized.

Rinsing with VE (DI) H₂O and absolutely stain-free drying
Through centrifugal force (G-Force)

Rinsing of wafers with VE (DI) h₂O (point of use filtration 0,2µ). Adaptable to soiling level of wafers through selection of rinsing intensity or duration.

Separate suction for the rotor axle as well as for driving parts by Complete flushing.

Fully automatic program flow via PLC

Monitoring of all safety and program functions.
Interface to building control.

Rinsing / drying cycle full automatically controlled.

Rinsing low speed.

Predrying at high end speed (1250 RPM)

Final drying at low speed (750 RPM), gentle processing of wafers guaranteed

Gesamte Horde (Scheiben) außerhalb der Rotordrehachse angeordnet (dadurch keine „Toten Flecken“ ohne Fliehkraft)

Rotor in 3-Achsen statisch sowie dynamisch gewuchtet. Qualitätsstufe 1.8 lt. VDI 2056

Rotortausch von oben leicht möglich (ca. 10-15min). Austausch ohne Verlust der Wuchtgüte möglich.

Verrohrung PVDF-UHP/PFA Schlauchverschraubungssystem FLARE-TEK

Ablauf mit Spülöffnung im Siphon sowie PVC-Klarsichtdeckel.

Anzeige der aktuellen Betriebsparameter. Im Falle einer Störung wird die Ursache am Display ausgegeben.

Ausführung lt. Richtlinie „Maschinen“ 89/392/EWG (CE-konform)
EN954-1/DIN ISO 13849-1

Gerät entspricht VBG 7 Zentrifugen

Kapazität:

ST-200/II Z - 2x25 wafers 8"
ST-150/II Z - 2x25 wafers 6"
ST 150/IV Z - 4x25 wafers 6"
ST-125/II Z - 2x25 wafers 5"
ST 100/IV Z - 4x25 wafers 4"

Adapter:

2x25 wafers 6"
2x25 wafers 5"
4x25 wafers 5"
2x25 wafers 4"
4x25 wafers 4"
4x25 wafers 3"

Whole carrier (wafers) placed outside of rotor axis (thus avoiding “dead spots” without gravity)

Rotor statically and dynamically balanced in 3 axes Quality level 1.8 acc. To VDE 2056.

Rotors easily replaceable (in about 5 minutes) and accessible from Top.

Tubing PVDF-HP/PFA with FLARE-TEK tube fixing system.

Discharge by siphon spillway with PVC transparent cover.

Display of actual operating parameters and in case of failure of cause of failure clear text display.

Manufactured acc. To directive “Machinery” D 89/392/EWG(CE)
EN954-1/DIN ISO 13849-1

Device in accordance with VBG 7 centrifuges.

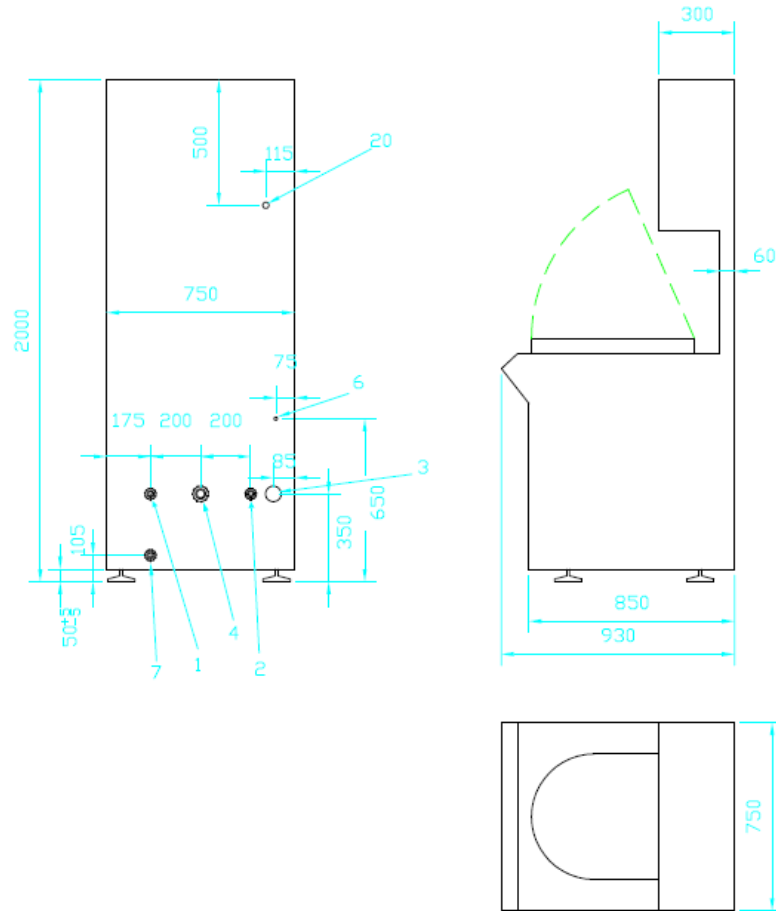
Capacity:

ST-200/II Z - 2x25 wafers 8"
ST-150/II Z - 2x25 wafers 6"
ST 150/IV Z - 4x25 wafers 6"
ST-125/II Z - 2x25 wafers 5"
ST 100/IV Z - 4x25 wafers 4"


ADAPTER:

2x25 wafers 6"
2x25 wafers 5"
4x25 wafers 4"

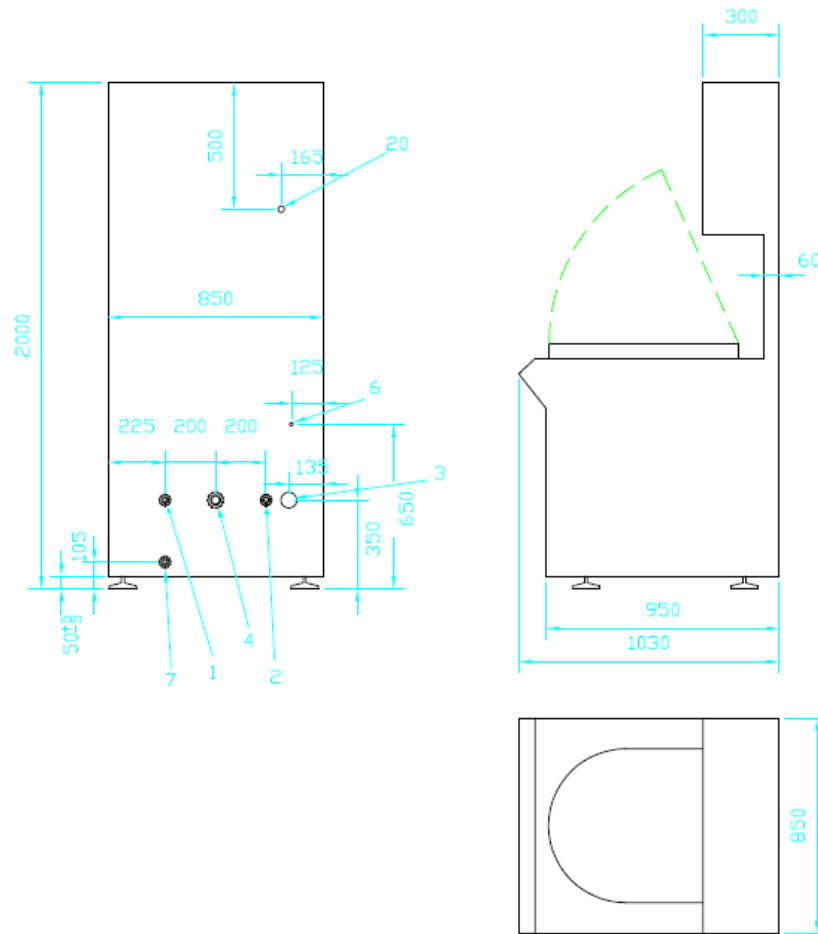
RefNr	Revisionshinweis	Datum	Unterschrift	Geprüft
-------	------------------	-------	--------------	---------




- 20 POWER 400VAC/3 PHASE 4KVA 50HZ
- 3 GENERAL EXHAUST DN25(ø32) PVDF
- 6 CA COMPRESSED AIR PK8
- 1 NITROGEN DN15(ø20)PVDF
- 2 DI-WATER DN15(ø20) PVDF
- 4 DRAIN DN32(ø40) PP
- 7 DRAIN DIP TRAY DN15(ø20) PP

Artikelref	Stk.	Material :			Artikel-Nr./Referenz	
Gez. von DI Stenitzer	Geprüft von ING. HUBER	Genehmigt von - Datum ING. HUBER - 05/12/02	Dateiname RD 150	Datum 05/12/02	Skala	
 Kunststoff- Verfahrenstechnik und Anlagenbau GmbH A-2490 Ebenfurth, Gewerbezone Ebenfurth Nr. 9 Tel.: 0043-(0)2624/54826 Fax.: Ext-18			RINSER DRYER ST 150 / II Z			
			Rückwand	Ausgabe 0	Blatt 1/1	

RefNr	Revisionshinweis	Datum	Unterschrift	Geprüft
-------	------------------	-------	--------------	---------



- 20 POWER 400VAC/3 PHASE 4KVA 50HZ
- 3 GENERAL EXHAUST DN25(Ø32) PVDF
- 6 CA COMPRESSED AIR PK8
- 1 NITROGEN DN15(Ø20)PVDF
- 2 DI-WATER DN15(Ø20) PVDF
- 4 DRAIN DN32(Ø40) PP
- 7 DRAIN DIP TRAY DN15(Ø20) PP

Artikelref	Stk.	Material :	Artikel-Nr./Referenz
Gez. von DI Stenitzer	Geprüft von ING. HUBER	Genehmigt von - Datum ING. HUBER - 05/12/02	Dateiname RD 150
			Datum 05/12/02
			Skala
 Kunststoff- Verfahrenstechnik und Anlagenbau GmbH A-2490 Ebenfurth, Gewerbezone Ebenfurth Nr. 9 Tel.: 0043-(0)2624/54826 Fax.: Ext-18			RINSER DRYER ST 150 / IV Z
			Rückwand
			Ausgabe 0
			Blatt 1/1

KVA RINSER- DRYER



KVA
Kunststoff Verfahrenstechnik-
und Anlagenbau GmbH

Kompaktgerät zum Spülen und Trocknen von Silizium- Scheiben
Compact station for rinsing and drying of silicon wafers

KVA Kunststoff- Verfahrenstechnik
und Anlagenbau GmbH
Gewerbezone Obj. 9, A-2490 Ebenfurth
Tel.: +43 (0) 2624-54826-0, Fax. Ext. 18